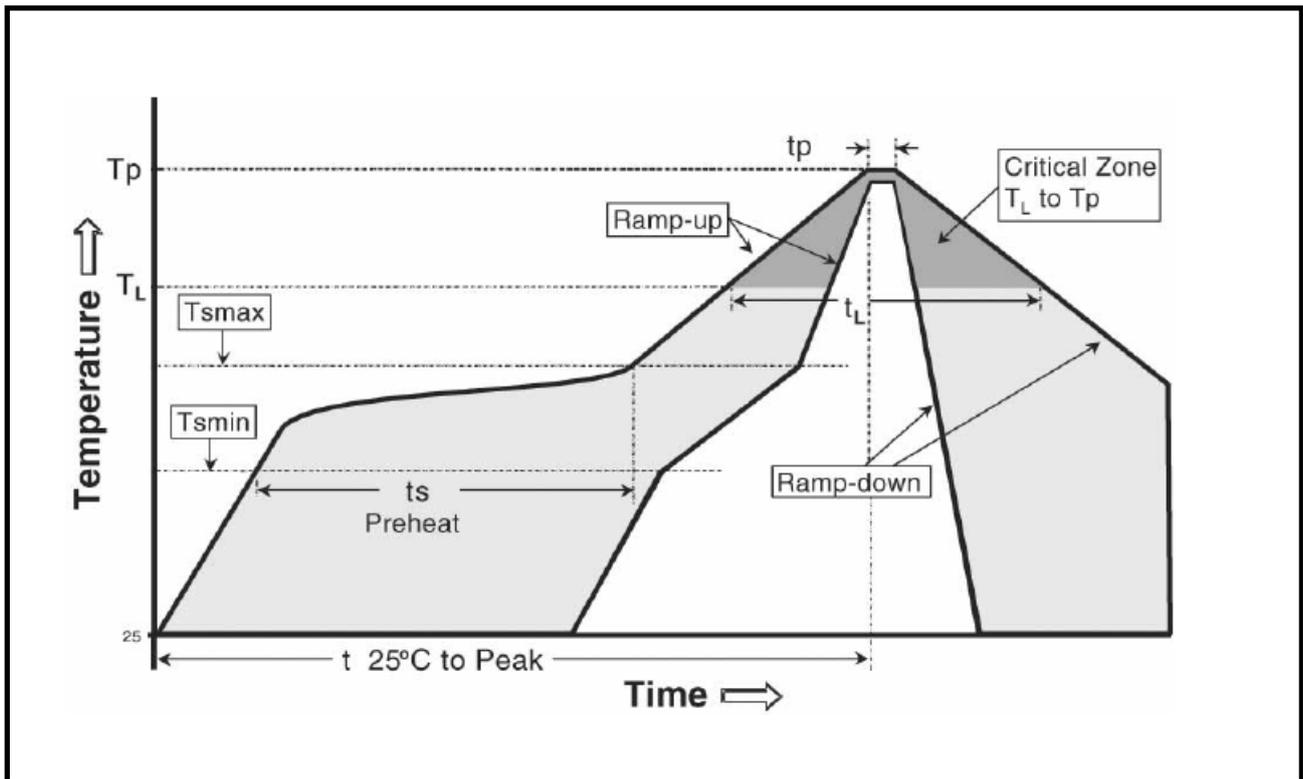


◆ Au-Sn封止製品のリフローはんだ付けについて

■ リフローはんだ付け条件



* リフロー温度条件は『IPC/JEDEC J-STD-020C 鉛フリーはんだ付け条件』に準拠

温度条件	記号	条件	単位
ランブアップ温度傾斜	Tsmax to Tp	3°C/秒 以下	°C/s
ランブダウン温度傾斜	Tcool	6°C/秒 以下	°C/s
室温からピーク温度までの時間	Tto-peak	8分 以下	分
プリヒート			
プリヒート温度下限	TSmin	150	°C
プリヒート温度上限	TSmax	200	°C
プリヒート時間	ts	60~180秒	秒
はんだ溶解時間			
はんだ溶解温度	TL	217	°C
はんだ溶解時間	tL	60~150秒	秒
ピーク温度			
ピーク温度	Tp	260°C	°C
ピーク温度時間 (『ピーク温度』-5°Cまでの時間)	tp	20~40秒	秒

※ リフローでの加熱方法についてのご注意

Microcrystalの以下のシリーズの製品は製品内部を真空に保っています。
赤外線リフローを用いた場合に、部分的にピーク時の温度が高くなることがあり
その際に製品のシーリング材の溶解温度を超えてリークが発生してしまう可能性があります。
(リークが発生してしまうと回復不可能な故障になります)

リフロー実装時には赤外線リフローを避けて別の方法で行われることを推奨致します。

(対象製品)

- ・リアルタイムクロックモジュール RV-xxxx-C2, RV-xxxx-C3, RV-xxxx-C7 シリーズ
- ・クロック水晶発振器 OV-7604-C7 シリーズ, MCSOシリーズ
- ・水晶振動子 CMxx シリーズ, CCxx シリーズ